

## PacTech präsentiert neuen Solder Ball Bumper „SB<sup>2</sup>-Compact“

PacTech kündigt heute den Bau Ihrer neuen Solder Jetting Plattform an. Die neue SB<sup>2</sup>-Compact erweitert ab November 2017 das Produktportfolio des in Nauen bei Berlin ansässigen Unternehmens.

Entwickelt wurde die Maschine als Kompaktvariante des PacTechs Verkaufsschlager dem Solder Ball Bumper SB<sup>2</sup>-SMs. Um dem Trend der komplexen Kontaktierung von Kameramodulen für Smartphones zu begegnen, wurde diese Plattform für schnelles Löten damals entwickelt. Die neue SB<sup>2</sup>-Compact besticht ebenfalls durch eine hohe Geschwindigkeit und Dynamik. Sie ist im Gegensatz zu Ihrer großen Schwester jedoch wesentlich kompakter und damit platzsparender. Ein hoher Durchsatz bei geringem Platzbedarf wird somit garantiert. Es können Lotkugeln mit einem Durchmesser von 250 µm bis 760 µm in den verschiedensten Legierungen platziert werden. Wobei PacTech auf Wunsch auch wesentlich kleinere Lotkugeln mit einem Durchmesser von bis zu 40µm aufbringen kann, dann jedoch mit einer anderen Solder Jetting Plattform. Die neue SB<sup>2</sup>-Compact wird sich auch durch eine benutzerfreundliche und einfachere Bedienung auszeichnen.

Außerdem bringt PacTech erstmalig Farbe ins Spiel. Mit verschiedenen Farbgestaltungsmöglichkeiten sorgt die SB<sup>2</sup>- Compact Maschine für einen Farbtupfer im tristen Einheitsgrau oder besser „Einheitsgelb“ der Reinräume.

Vorrangig ist die Maschine für das Löten von Kamera Modulen oder mikrooptischen Linsen konzipiert worden, sowie für das Drahtbonden. Als Spezialmaschinenhersteller kann PacTech äußerst flexibel auf Kundenwünsche und -anforderungen eingehen. Die Kunden akquiriert das Unternehmen vorrangig aus den Bereichen Telekommunikation, Automotive und Medizin.

Mit der neuen SB<sup>2</sup>-Compact bietet PacTech nun eine kostenoptimierte Lösung für Unternehmen die in kleinerer Volumenzahl, aber dennoch zügig und genau prozessieren müssen.



Sep 13, 2017